苏州猎奇智能设备股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第一届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	高端智能装备制造建设项目	58,240.78	58,240.78
2	研发中心建设项目	25,100.61	25,100.61
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		**91,341.39**	**91,341.39**

在本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资，以保证项目的顺利实施；若本次发行实际募集资金超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）高端智能装备制造建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为猎奇智能，项目总投资 58,240.78 万元，建设期为 3 年。公司计划新建智能化生产线，项目建筑面积 56,000.00 平方米，并引入先进的生产设备，扩大公司现有产能，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求。

2、项目投资概算

本项目总投资为 58,240.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	**建设投资**	**48,846.70**	**83.87%**
1.1	建筑工程费	23,303.33	40.01%
1.2	设备购置费	19,224.90	33.01%
1.3	安装工程费	523.50	0.90%
1.4	工程建设其他费用	3,510.60	6.03%
1.5	预备费	2,284.37	3.92%
2	**铺底流动资金**	**9,394.08**	**16.13%**
合计		**58,240.78**	**100.00%**

注：工程建设其他费用中包含土地购置费 875 万元

3、项目实施进度

本项目建设期拟定为 3 年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、试生产。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**
1	前期准备												
2	勘察设计												
3	土建施工												
4	设备采购与安装调试												
5	人员招聘与培训												
6	试生产												

4、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于江苏省苏州市昆山市高新技术开发区北门路东侧、龙生路南侧，用地面积约 35 亩，周边配套设施齐全。截至本招股意向书出具日，公司已取得苏（2026）昆山市不动产权第 3010906 号不动产权证书。

5、环保影响及措施

本项目建成后主要进行光模块封装测试设备的装配、生产，不属于重污染行业。本项目将在建设过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的少量废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

6、项目经济效应分析

项目建成投产后，项目达产年营业收入 151,070.80 万元，投资回收期为 6.60 年（含建设期），税后内部收益率为 28.21%。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为猎奇智能，项目总投资 25,100.61 万元，建设期为 3 年。公司计划新建研发中心，建立功能完善的研究实验室，购置先进的研发、试验设备和软件，并通过引进机械、光学、软件等领域的高端研发人才以扩充公司技术研发团队。同时，公司还将根据光模块行业发展趋势，开展前瞻性技术研发，向半导体领域封装设备进行技术延伸，以持续提升公司的技术研发实力和综合竞争力。

2、项目投资概算

本项目总投资为 25,100.61 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	**建设投资**	**11,160.45**	**44.46%**
1.1	建筑工程费	5,225.00	20.82%
1.2	设备购置费	4,122.73	16.42%
1.3	安装工程费	72.51	0.29%
1.4	工程建设其他费用	544.94	2.17%
1.5	预备费	1,195.27	4.76%
2	**研究开发费用**	**13,940.16**	**55.54%**

序号	项目	投资额	占总投资的比例
2.1	研发人员工资	9,845.66	39.22%
2.2	研发耗材费用	3,824.50	15.24%
2.3	检测费等其他研发费用	270.00	1.08%
合计		**25,100.61**	**100.00%**

3、项目研发方向

本项目研发方向具体如下表所示：

序号	研发方向	研发课题
1	产品迭代升级	芯片级老化测试设备的研发、高精度多芯片混合贴片设备的研发、高精度倒装贴片设备的研发
2	前瞻性技术储备	TCB 热压键合封装设备的研发、Chip to Wafer 封装工艺贴片设备的研发、PLP 封装工艺贴片设备的研发、晶圆级耦合工艺开发
3	应用领域拓展	IC 高速固晶贴片设备的研发、微组装工艺的研发

4、项目实施进度

本项目建设期拟定为 3 年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训、课题研发等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	■											
2	勘察设计	■	■										
3	土建施工		■	■	■	■	■						
4	设备采购、安装与调试					■	■	■	■	■	■		
5	人员招聘与培训									■	■	■	■
6	课题研发	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于江苏省苏州市昆山市高新技术开发区北门路东侧、龙生路南侧，用地面积约 35 亩，周边配套设施齐全。截至本招股意向书出具日，公司已取得苏（2026）昆山市不动产权第 3010906 号不动产权证书。

6、环保影响及措施

本项目建成后主要进行光模块、半导体封装测试设备的研发，不属于生产性项目，不属于重污染行业。本项目将在建设过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。

7、项目经济效应分析

本项目投资于研发中心建设及课题研发，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价，但项目投入使用后，将对公司长远发展产生重要支撑作用，进一步夯实并提升公司的技术研发实力，拓展公司业务的覆盖范围与深度，强化公司的核心竞争力，从而有力推动公司的可持续发展进程。

（三）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 8,000.00 万元用于补充流动资金，本项目不涉及备案及环境影响评价等事项。报告期内，公司营收规模扩张较快，对营运资金的需求持续增加。随着公司经营规模的不断扩大，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金迅速增加，公司除了要进行生产厂房建设、生产设备的购置等固定资产投资外，还需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。公司所处光通信、半导体行业，需要持续进行研发投入以保证技术领先性和产品的市场竞争优势。同时，公司所处行业为知识密集型和人才密集型行业，保留和吸引高端人才对公司的发展经营具有重要意义。

本次补充流动资金将成为公司在研发团队建设、业务拓展和日常营运方面的重要资金来源，对公司研发投入和人才队伍建设给予有力的支持。公司将进一步巩固在光通信封装测试设备行业的市场地位，增加市场竞争力和影响力，提升核心竞争力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》的盖章页）



苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 11 月 18 日